

# 平成19年3月期(第5期)決算説明会

平成19年5月21日  
株式会社ジーダット



**1.平成19年3月期 業績**

2.平成20年3月期 業績予想

3.米国Takumi社との業務および資本提携に関して

# 平成19年3月期業績概要(連結)

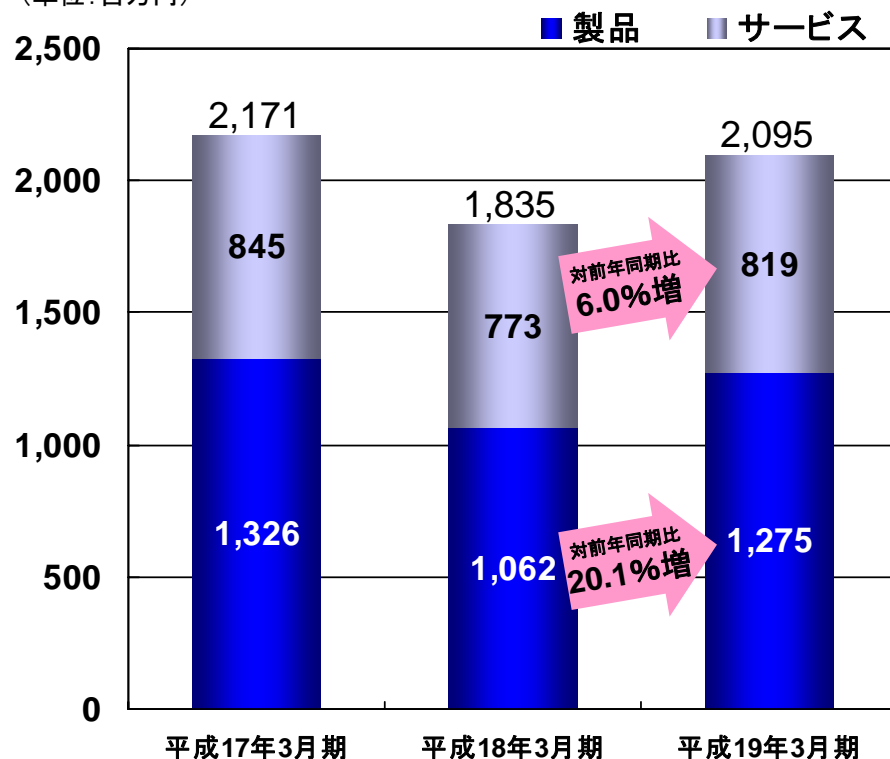
(単位:百万円)

|                | 平成17年3月期業績 |        | 平成18年3月期業績 |        | 平成19年3月期業績 |        |        |
|----------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------|
|                | 実績         | 売上高比   | 実績         | 売上高比   | 実績         | 売上高比   | 対前年同期比 |
| 売上高            | 2,171      | 100.0% | 1,835      | 100.0% | 2,095      | 100.0% | +14.2% |
| 売上総利益          | 1,537      | 70.8%  | 1,284      | 70.0%  | 1,473      | 70.3%  | +14.7% |
| 販売費及び<br>一般管理費 | 1,114      | 51.3%  | 1,141      | 62.2%  | 1,266      | 60.4%  | +10.9% |
| 営業利益           | 423        | 19.5%  | 142        | 7.8%   | 207        | 9.9%   | +45.2% |
| 経常利益           | 468        | 21.6%  | 185        | 10.1%  | 290        | 13.9%  | +57.1% |
| 当期純利益          | 332        | 15.3%  | 124        | 6.8%   | 189        | 9.0%   | +52.3% |

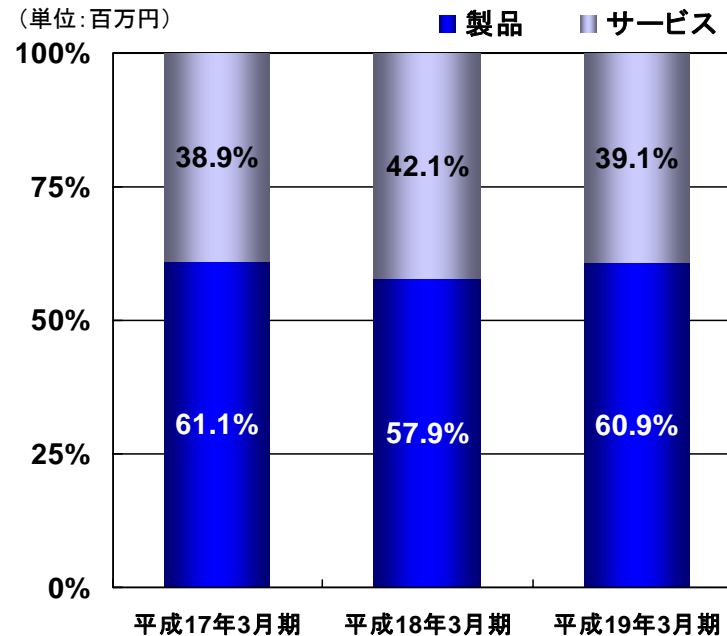
# 事業別売上高の推移(連結)

## 【製品/サービス別】

(単位:百万円)



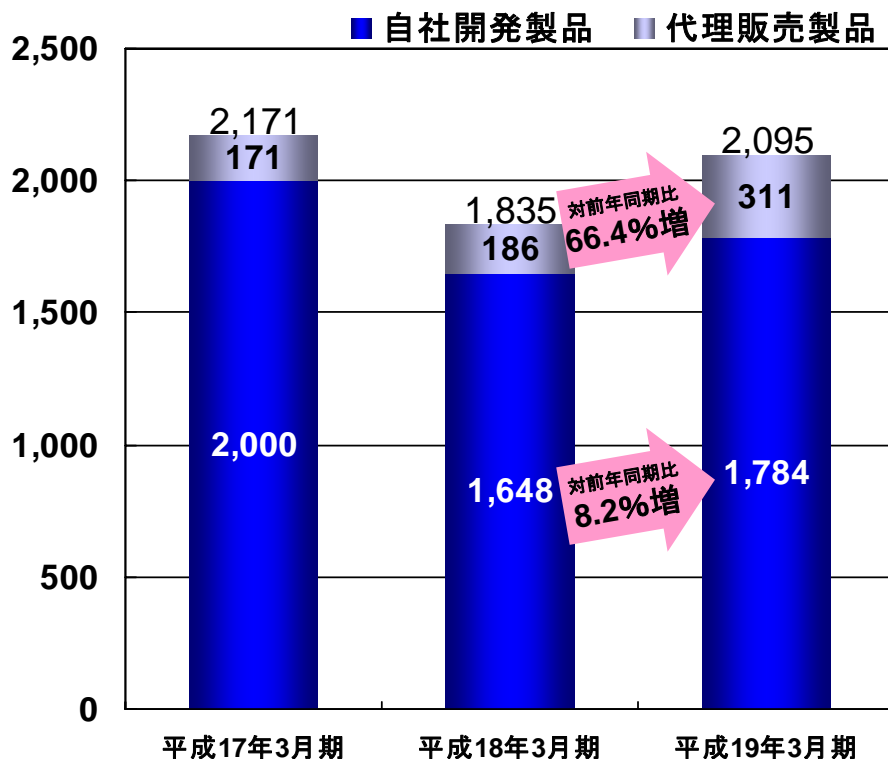
(単位:百万円)



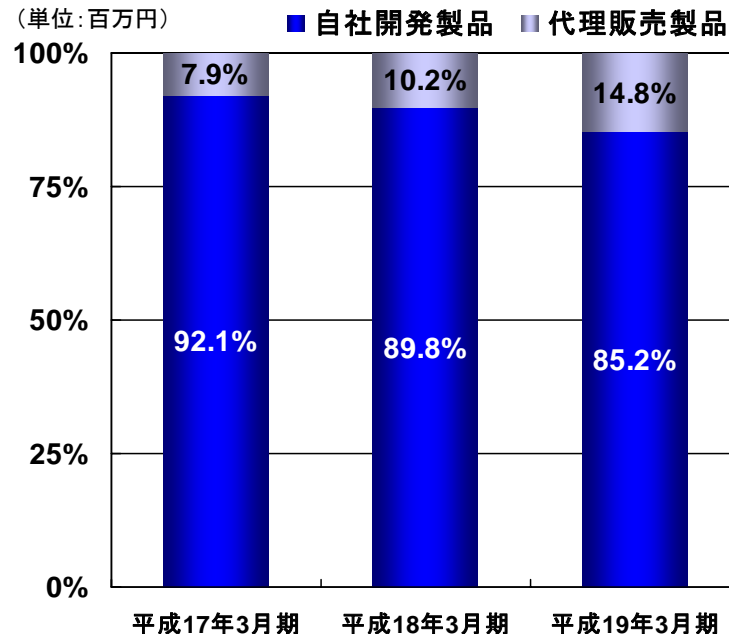
# 事業別売上高の推移(連結)

## 【自社開発製品/代理販売製品別】

(単位:百万円)



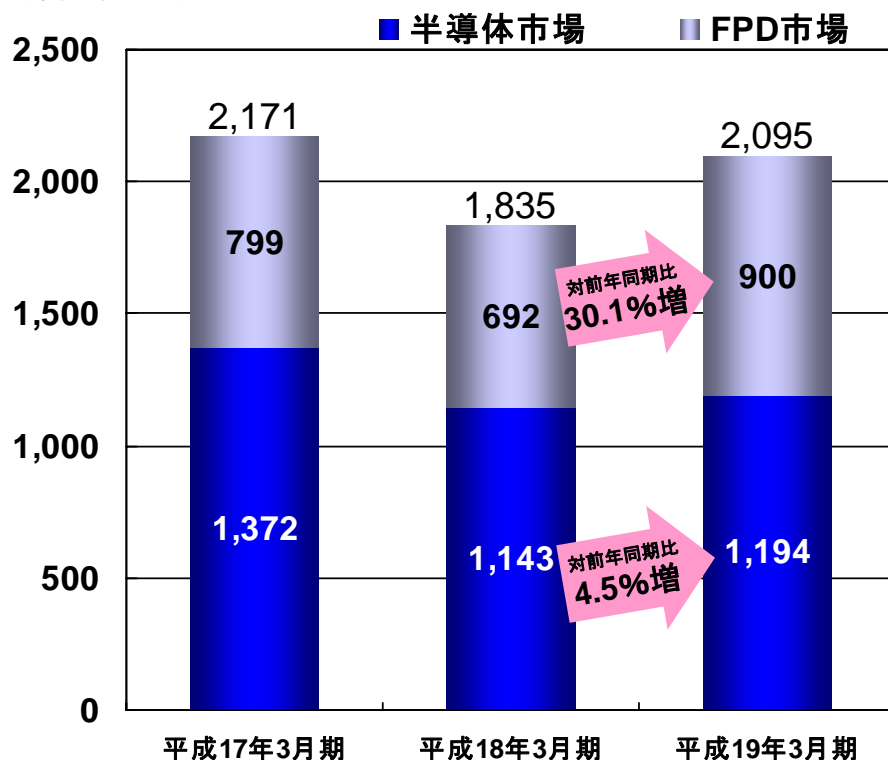
(単位:百万円)



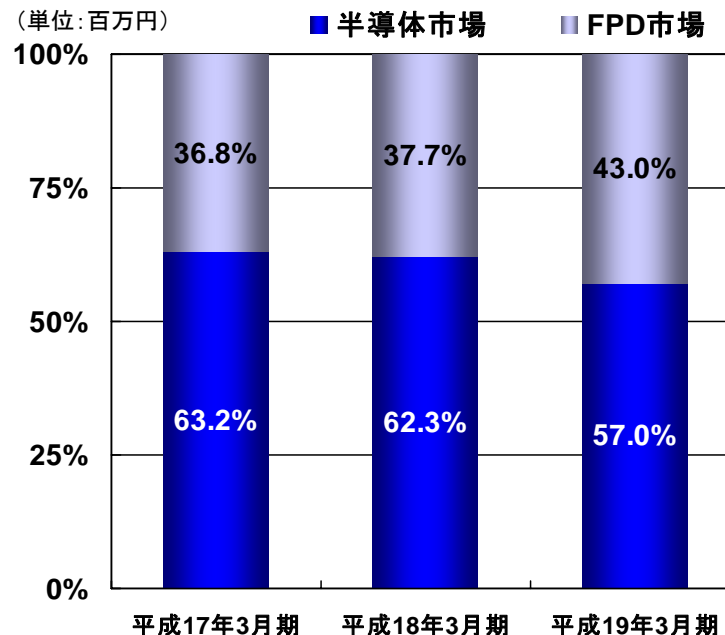
# 事業別売上高の推移(連結)

## 【半導体市場/FPD市場別】

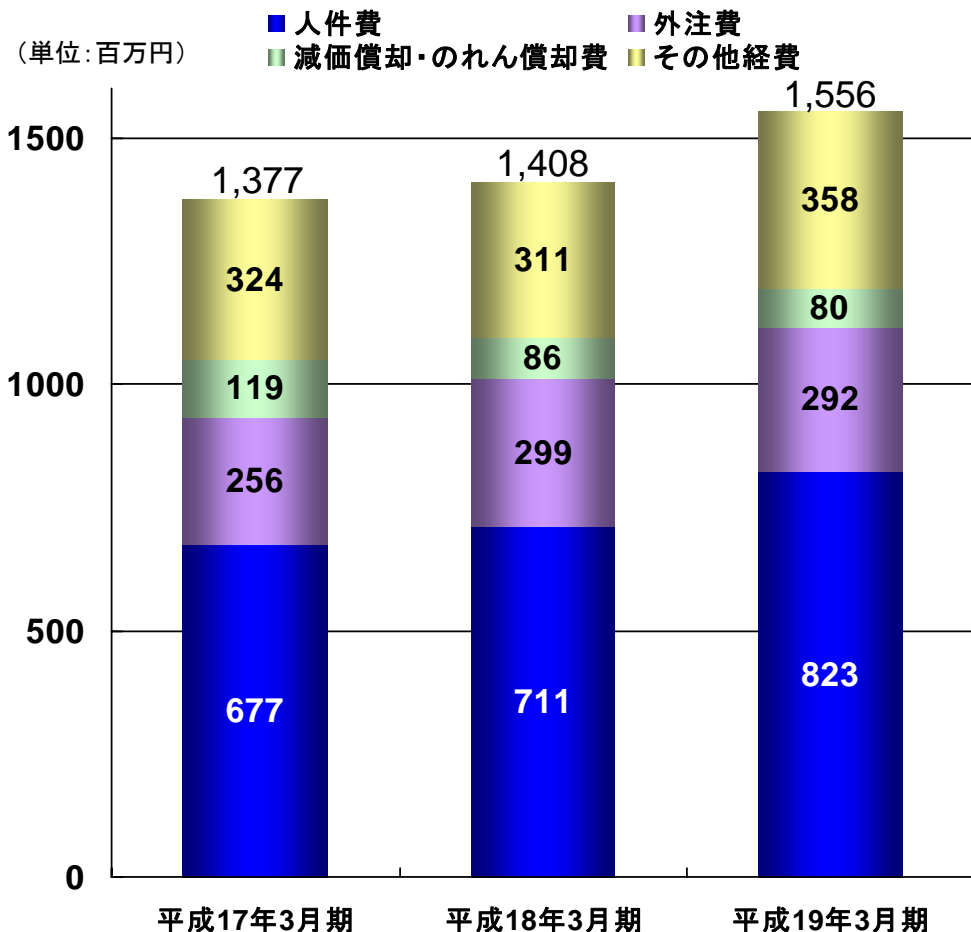
(単位:百万円)



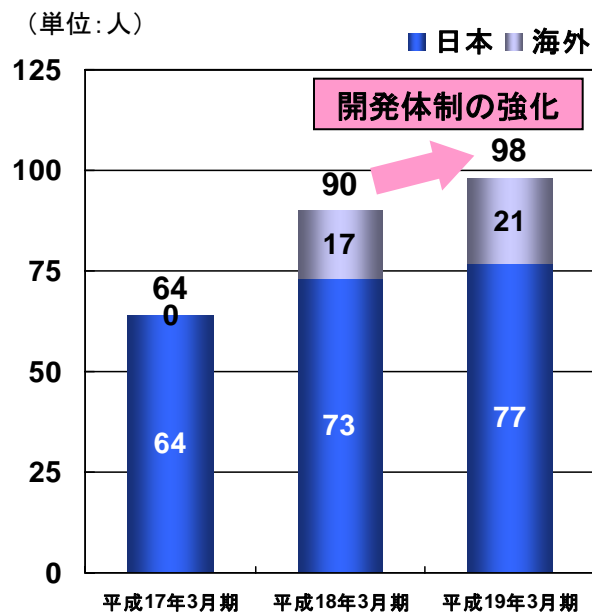
(単位:百万円)



# 固定費内訳推移(連結)



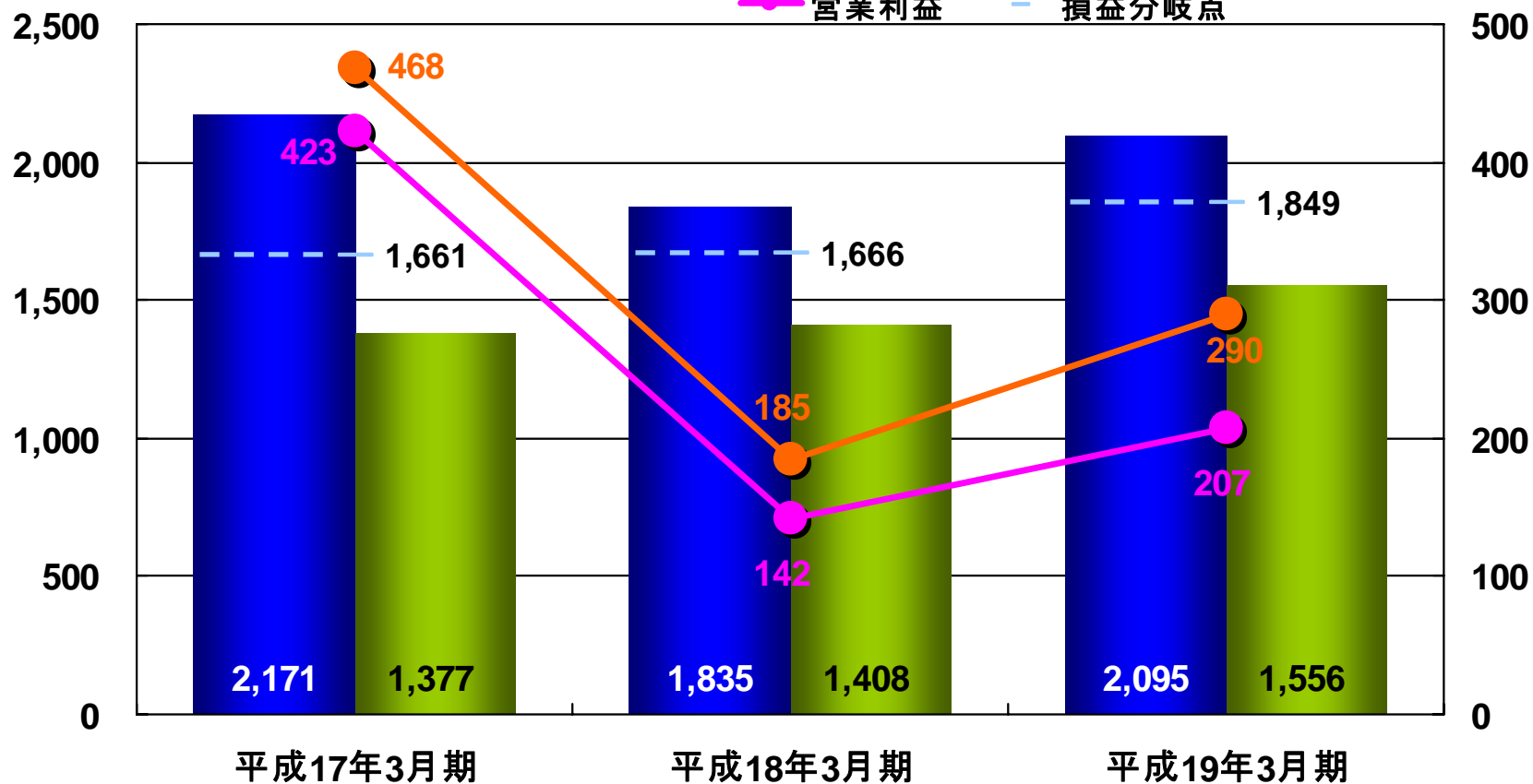
【期末要員数】



# 売上・利益の推移

(単位:百万円)

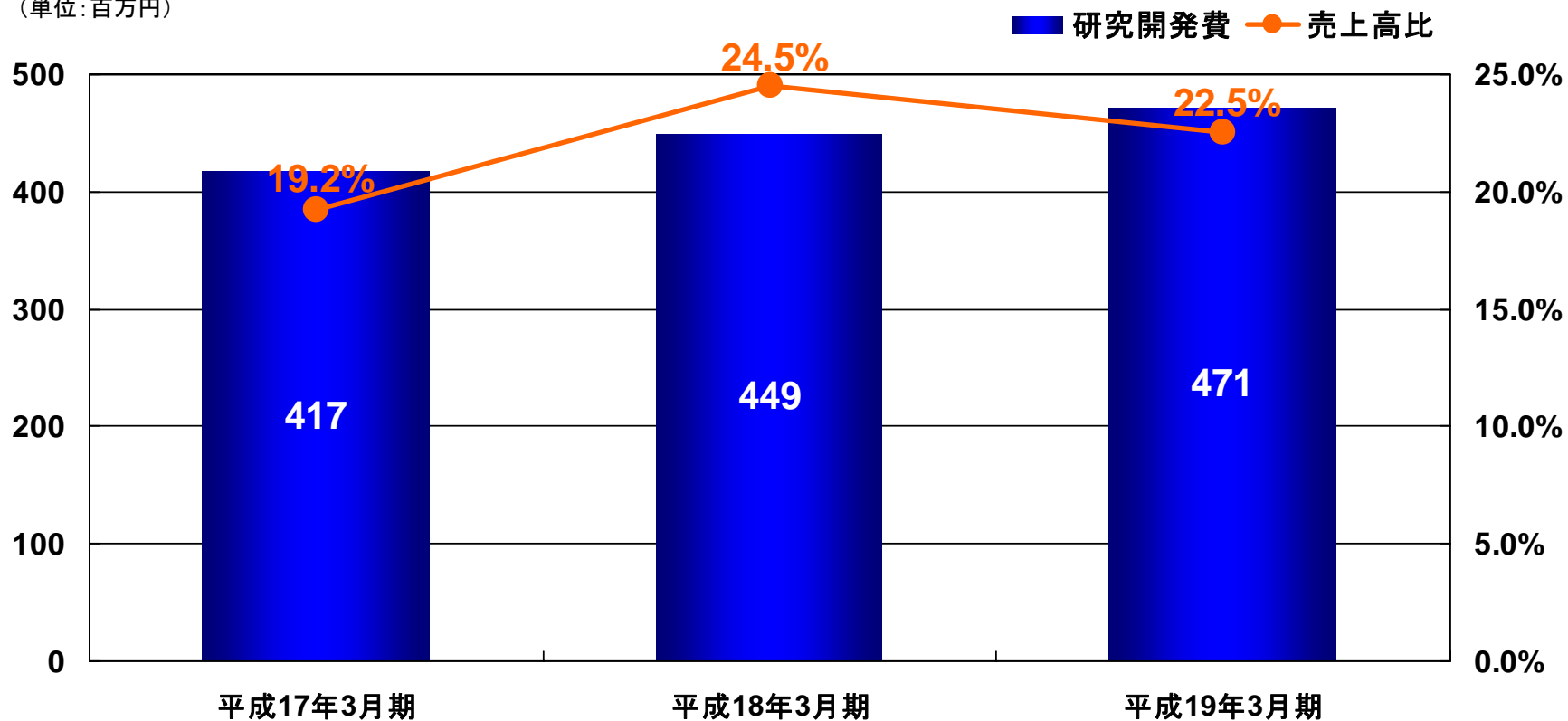
■ 売上高    ■ 固定費    ● 経常利益  
● 営業利益    - - 損益分岐点





# 研究開発費の推移

(単位:百万円)



アナログ設計分野 研究開発  
DFM分野 研究開発

# 連結貸借対照表

(単位:百万円)

|                | 平成18年<br>3月期末 | 平成19年<br>3月期末 | 差異           |                    | 平成18年<br>3月期末 | 平成19年<br>3月期末 | 差異           |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>(資産の部)</b>  |               |               |              | <b>(負債の部)</b>      |               |               |              |
| <b>I 流動資産</b>  | <b>1,126</b>  | <b>2,488</b>  | <b>1,361</b> | <b>I 流動負債</b>      | <b>368</b>    | <b>502</b>    | <b>134</b>   |
| 1 現金及び預金       | 617           | 1,917         | 1,299        | 1 買掛金              | 120           | 138           | 18           |
| 2 受取手形及び売掛金    | 420           | 481           | 60           | 2 未払法人税等           | 69            | 101           | 32           |
| 3 たな卸資産        | 23            | 17            | △ 5          | 3 賞与引当金            | 69            | 82            | 13           |
| 4 繰延税金資産       | 34            | 42            | 8            | 4 その他              | 109           | 179           | 70           |
| 5 その他          | 30            | 29            | △ 1          | <b>負債合計</b>        | <b>368</b>    | <b>502</b>    | <b>134</b>   |
| <b>II 固定資産</b> | <b>334</b>    | <b>310</b>    | <b>△ 24</b>  | <b>(純資産の部)</b>     |               |               |              |
| 1 有形固定資産       | 17            | 21            | 4            | <b>I 株主資本</b>      | <b>1,090</b>  | <b>2,293</b>  | <b>1,202</b> |
| 2 無形固定資産       | 145           | 78            | △ 66         | 1 資本金              | 253           | 760           | 506          |
| (1) のれん        | 143           | 71            | △ 71         | 2 資本準備金            | 383           | 890           | 506          |
| (2) ソフトウェア     | 1             | 6             | 5            | 3 利益剰余金            | 453           | 642           | 189          |
| 3 投資その他の資産合計   | 172           | 210           | 38           | <b>II 評価・換算差額等</b> | <b>1</b>      | <b>2</b>      | <b>0</b>     |
|                |               |               |              | 為替換算調整勘定           | 1             | 2             | 0            |
|                |               |               |              | <b>純資産合計</b>       | <b>1,092</b>  | <b>2,295</b>  | <b>1,203</b> |
| <b>資産合計</b>    | <b>1,461</b>  | <b>2,798</b>  | <b>1,337</b> | <b>負債純資産合計</b>     | <b>1,461</b>  | <b>2,798</b>  | <b>1,337</b> |

第三者割当増資による新株発行(H18年9月28日):548百万円  
 公募増資による新株発行(H19年3月15日):464百万円  
 自己資本比率:74.8%⇒82.0%

# 連結キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

|                      | 平成18年<br>3月期末 | 平成19年<br>3月期末 | 差異    |
|----------------------|---------------|---------------|-------|
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー   | 42            | 319           | 276   |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  | △13           | △24           | △11   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105           | 1,004         | 898   |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額  | 1             | 0             | 0     |
| V 現金及び現金同等物の増減額      | 137           | 1,299         | 1,162 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高    | 480           | 617           | 137   |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高   | 617           | 1,917         | 1,299 |

1.平成19年3月期 業績

**2.平成20年3月期 業績予想**

3.米国Takumi社との業務および資本提携に関して

# 平成20年3月期予想(連結)

(単位:百万円)

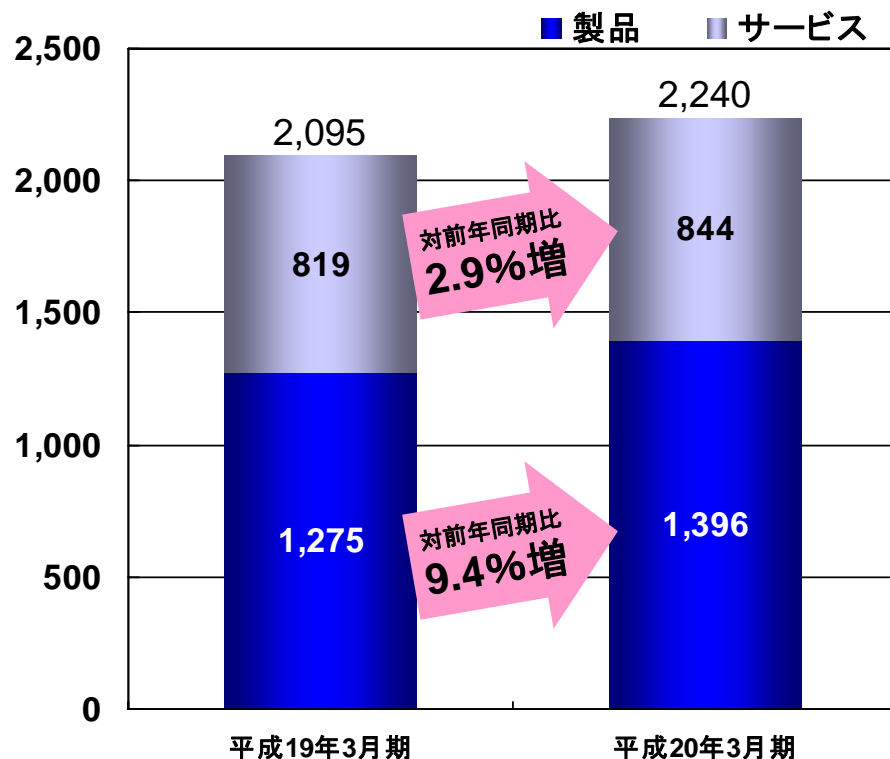
|                | 平成19年3月期業績 |        | 平成20年3月期業績予想 |        |        |
|----------------|------------|--------|--------------|--------|--------|
|                | 実績         | 売上高比   | 予想           | 売上高比   | 対前年同期比 |
| 売上高            | 2,095      | 100.0% | 2,240        | 100.0% | +6.9%  |
| 売上総利益          | 1,473      | 70.3%  | 1,532        | 68.4%  | +4.0%  |
| 販売費及び<br>一般管理費 | 1,266      | 60.4%  | 1,276        | 57.0%  | +0.8%  |
| 営業利益           | 207        | 9.9%   | 256          | 11.4%  | +23.7% |
| 経常利益           | 290        | 13.9%  | 310          | 13.8%  | +6.5%  |
| 当期純利益          | 189        | 9.0%   | 200          | 8.9%   | +5.8%  |

営業利益の伸びに対して、経常利益、当期純利益の伸びが低いのは、受取研究開発助成金が当連結会計年度比42百万円(45.4%)減少の51百万円を見込んでいるためであります。

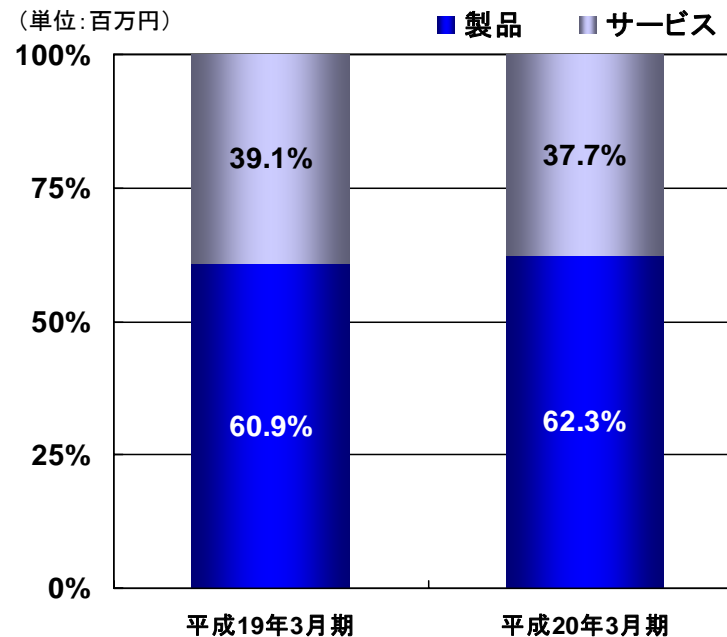
# 事業別売上高の推移(連結)

## 【製品/サービス別】

(単位:百万円)



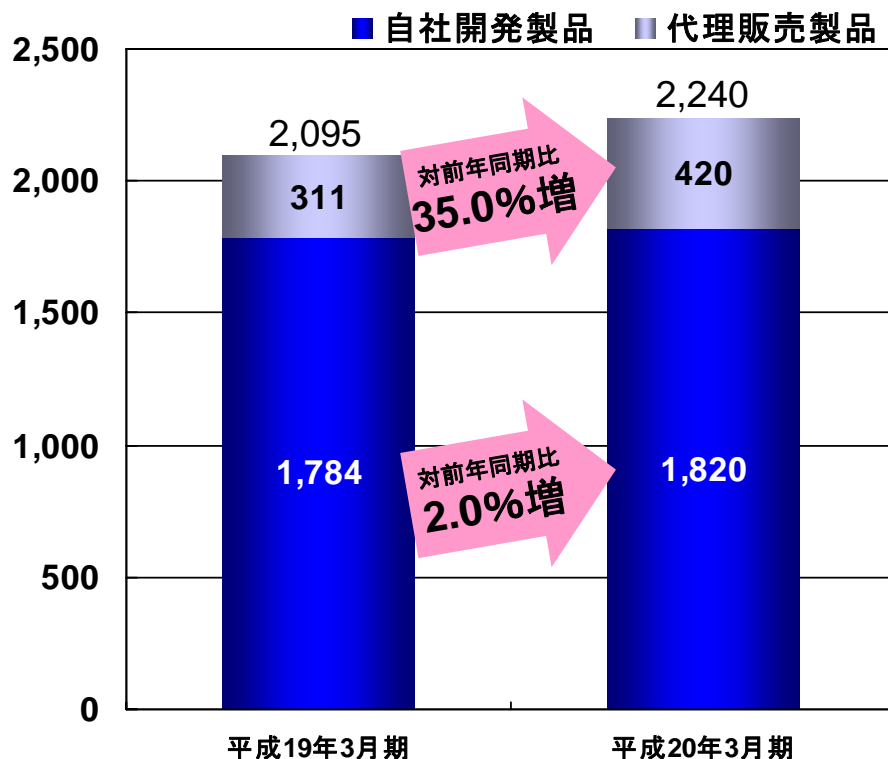
(単位:百万円)



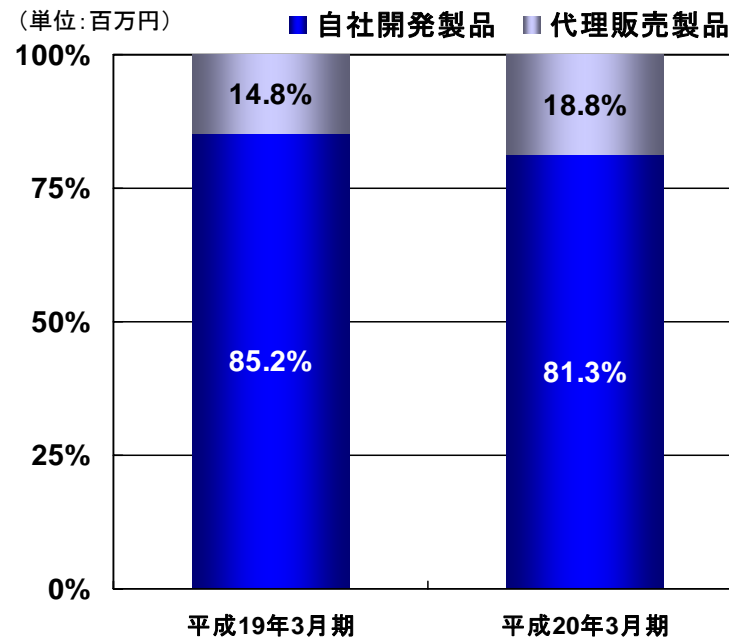
# 事業別売上高の推移(連結)

## 【自社開発製品/代理販売製品別】

(単位:百万円)



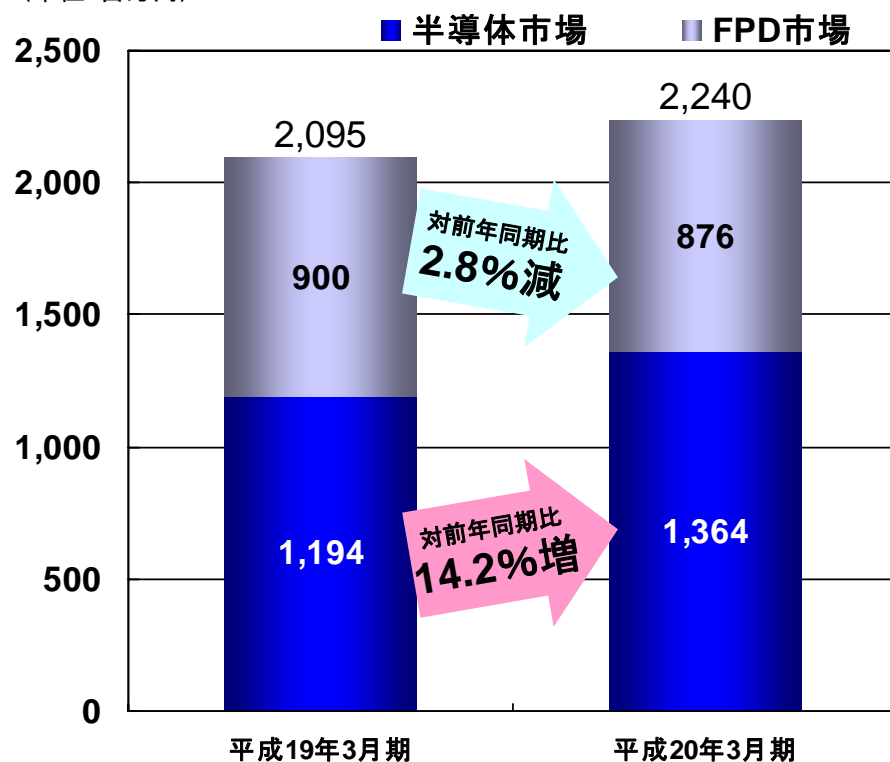
(単位:百万円)



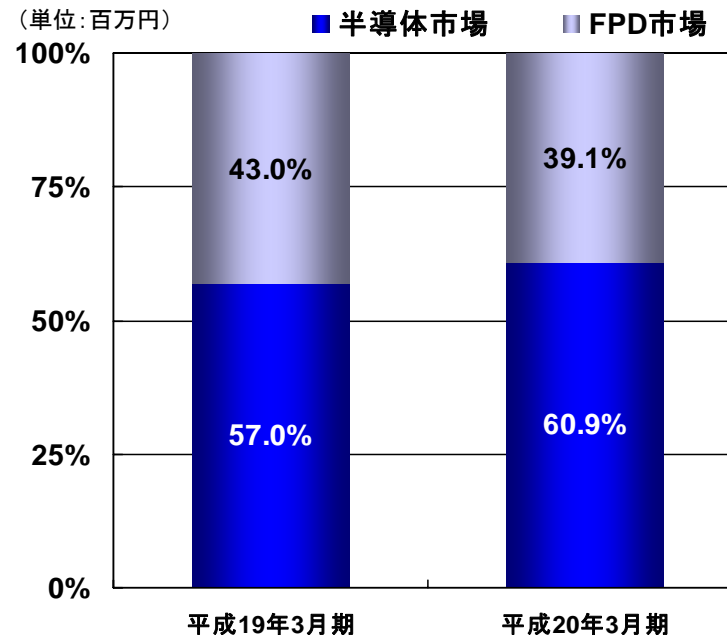
# 事業別売上高の推移(連結)

## 【半導体市場/FPD市場別】

(単位:百万円)

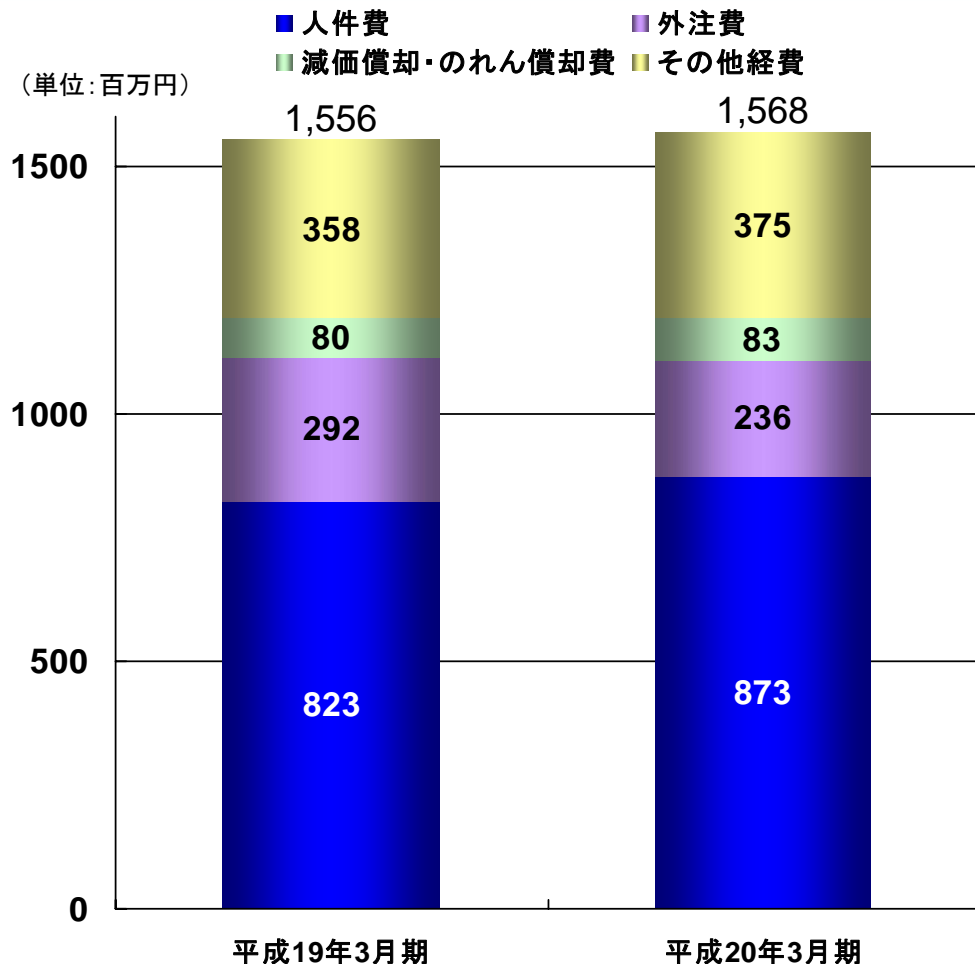


(単位:百万円)

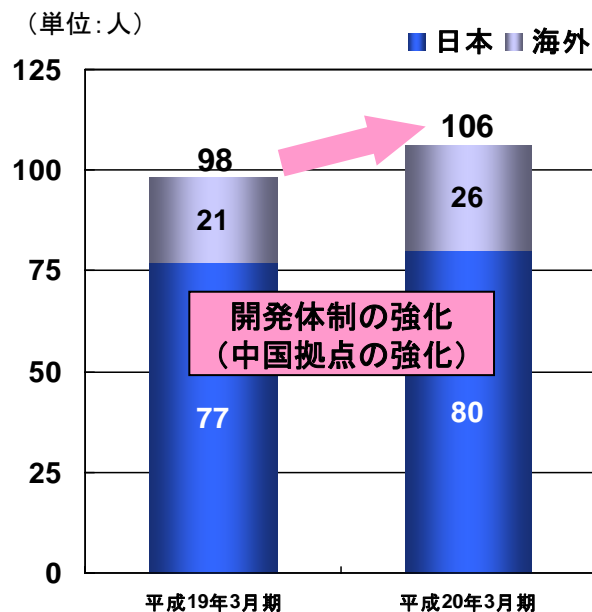




# 固定費内訳推移(連結)

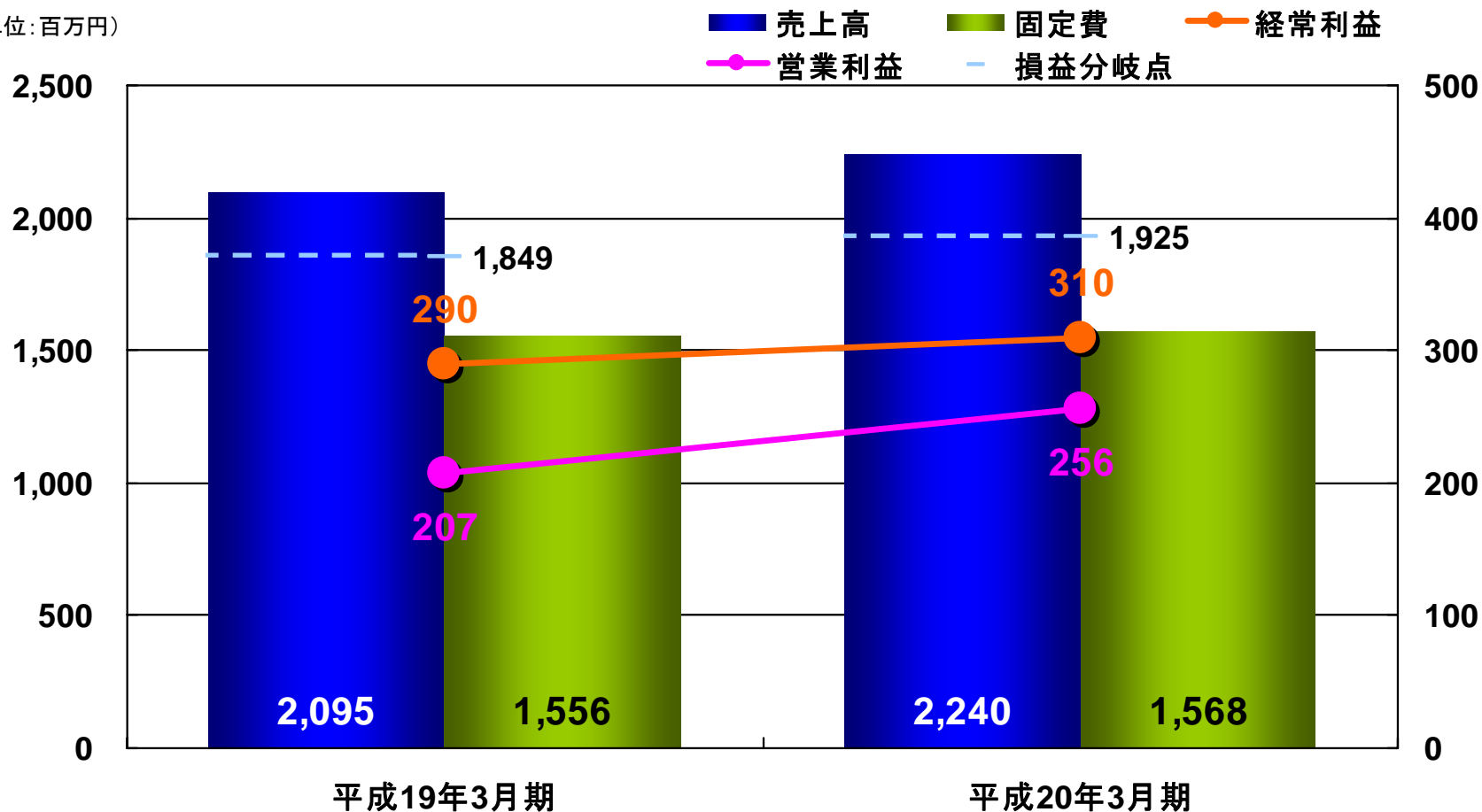


【期末要員数】



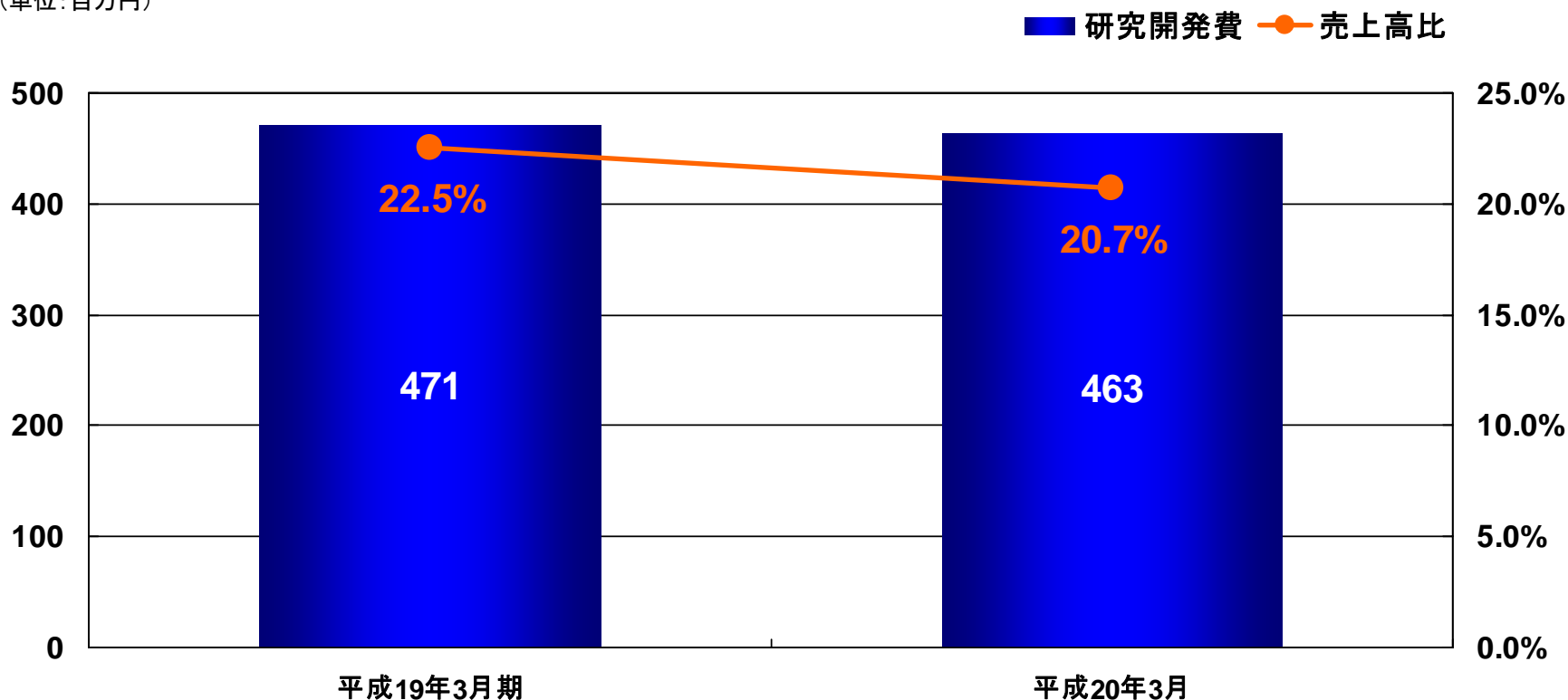
# 売上・利益の推移

(単位:百万円)



# 研究開発費の推移

(単位:百万円)



アナログ設計分野 研究開発  
DFM分野 研究開発

研究開発助成金によるプロジェクトが2テーマから1テーマへと減少しております。それに合わせて、開発体制を見直しております。

# 重点課題と施策

## 1. 半導体市場の売上増 → 競合市場のリプレース

- ▶ フォーカスするアナログ、メモリ、イメージセンサー、LCD\*ドライバー等のフルカスタム設計分野で、各種自動系機能のさらなる強化をはかり、競合に対する技術的な優位性を拡大する。
- ▶ 設計経験者の採用等により、「製品の使い方」から「設計効率の向上」へと、サポートの質の転換をはかる。

## 2. DFM\*市場への進出 → 代理販売製品による市場開拓と自社技術の蓄積

- ▶ 製品開発、海外販売におけるパートナー企業とのコラボレーションの強化をはかる。
- ▶ 自社製品との組み合わせによる、設計フローの提案を行う。

\*LCD : Liquid Crystal Display , 液晶ディスプレイ

\*DFM : Design For Manufacturability , 半導体製造の事を考慮した設計手法 / 設計ツール

1.平成19年3月期 業績

2.平成20年3月期 業績予想

**3.米国Takumi社との業務および資本提携に関して**

# 提携の目的

## DFM分野への製品ラインアップ、ソリューションの強化

### Jedat社の既取扱製品

- ▶ **CMP-Designer**  
(自社開発のCMP\*シミュレータ)
- ▶ **HOTSCOPE**  
(大日本印刷株式会社製DFM\*ビューワ)
- ▶ **EYES/PEYE**  
(英国Predictions Software Ltd.社製  
歩留まり解析ツール)
- ▶ **InShape / OutPerform**  
(米国Clear Shape Technologies社製  
ホットスポット\*解析)



### Takumi社との提携

- ▶ **ホットスポットの自動解消による、歩留まり向上と早期量産化**  
ホットスポット自動解消機能
- ▶ **マスク製造手戻りの削減による、開発期間とコストの大幅削減**  
マスク欠陥解析機能

\* DFM : Design For Manufacturability, 半導体製造の事を考慮した設計手法 / 設計ツール

\* CMP : Chemical Mechanical Polishing, 半導体の製造プロセスの1つ、化学的機械的研磨技術

\* ホットスポット : 半導体製造時に欠陥となる可能性が高い危険箇所

# 提携の内容

## ▶ 業務提携

日本国内での販売代理店契約

## ▶ 製品

| 製品名                         | 概要                           | ターゲット                                       |
|-----------------------------|------------------------------|---|
| Takumi Enhance              | ライブラリを対象としたホットスポット自動解消ツール    | 大手IDM*基盤開発部門                                |
| Takumi HSF<br>(Hotspot Fix) | 大規模フルチップを対象としたホットスポット自動解消ツール | 大手IDM基盤開発部門、ファブレスメーカー<br>または大手IDM内のLSI*設計部門 |
| Takumi Defect Analyzer      | マスク欠陥解析ツール                   | マスク製造企業                                     |

\*IDM：Integrated Device Manufacturer，設計から製造まで行う垂直統合型デバイスメーカー  
\*LSI：Large Scale Integrated Circuit，大規模IC

## ▶ 販売の見通し

今後3年間に総額5~10億円の売上を見込む  
(現時点において、平成20年3月期の当社の業績に与える影響は軽微)

## ▶ 資本提携

この業務提携を期にTakumi社に\$1Mの投資を実施  
(両社の将来的な技術交流を視野に入れ、関係をより強固にする狙い)

# 米国Takumi社の概要

- ▶ 商号 Takumi Technology Corporation
- ▶ 所在地 150 Mathilda Place, Suite 288 Sunnyvale, CA 94086
- ▶ 代表者 Akifumi Goto, CEO & President
- ▶ 設立 2003年10月
- ▶ 資本金 \$14.5M
- ▶ 従業員数 約50名
- ▶ 売上高 約\$5M(2006年11月期実績)  
約\$8M(2007年11月期計画)
- ▶ 業務内容 半導体向けEDA分野のDFMにフォーカスした製品の開発・販売・サポート

## 業務及び資本提携契約の日程

- ▶ 平成19年5月16日 取締役会決議
- ▶ 平成19年5月16日 提携開始



**ご清聴有難うございました**